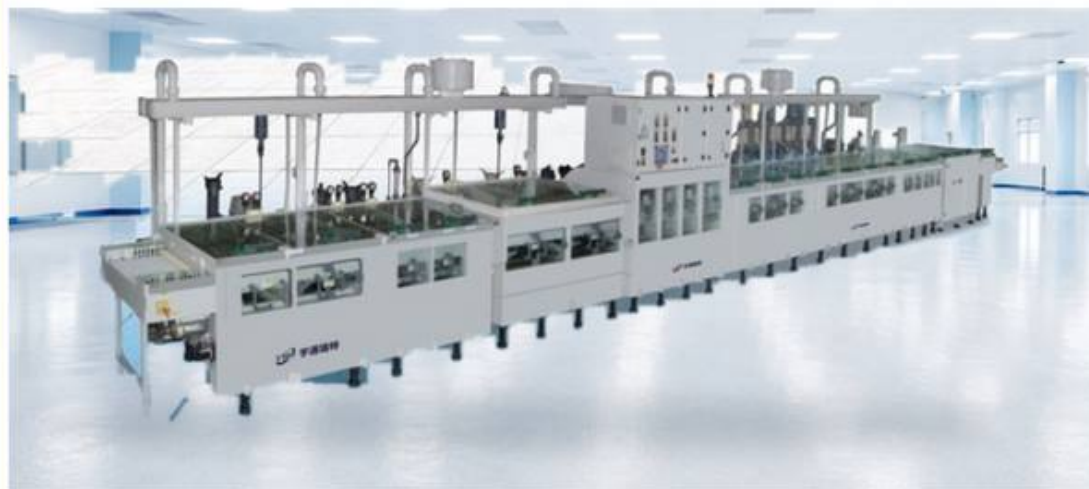


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Горизонтальные и вертикальные линии мокрых процессов
для PCB, FPCB, керамических подложек и полупроводников.



НАДЁЖНОСТЬ

Стабильные процессы

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Интеграция с MES

СЕРВИС

Поддержка и обучение

ПРЯМАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ BLACK SHADOW



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прозрачные панели для контроля процесса.
- Стабильная циркуляция кондиционирующего состава.
- Равномерное нанесение проводящей углеродной плёнки.
- Поддержка FPCB толщиной от 0,06 мм.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прямая металлизация отверстий углеродным проводящим слоем.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



ПРЯМАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ BLACK HOLE



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наблюдение за процессом через прозрачные панели.
- Контроль расхода и температуры растворов.
- Равномерное нанесение коллоидного графита.
- Система фильтрации снижает перенос раствора.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прямая металлизация отверстий графитовым проводящим слоем.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

